



フィルム貼付巻取り装置

**DH-EF700****DATA**

本装置は、レジストインキの平滑化装置です。

入側コンベアに搬送ワークを投入すると、  
センタリング、ラミネート及びレジストインキ平滑化、ラミネートフィルムのセパレートを自動で行ないます。  
温度センサは非接触型のものを採用し発塵のない設計となっております。

## 〈簡易概略〉

- |          |   |
|----------|---|
| ・装置寸法    | 約(W)2580×(D)1700(段取り時後退位置2000)×(H)1900±30mm |
| ・処理速度    | 0.3～4m/min                                  |
| ・ワークサイズ幅 | MAX510mm                                    |
| ・電源電圧    | 各種対応  |